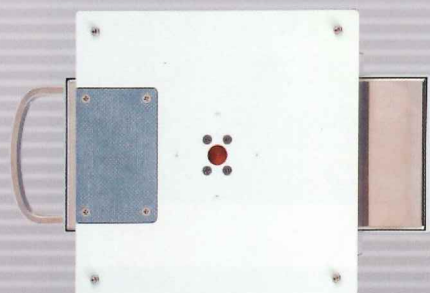
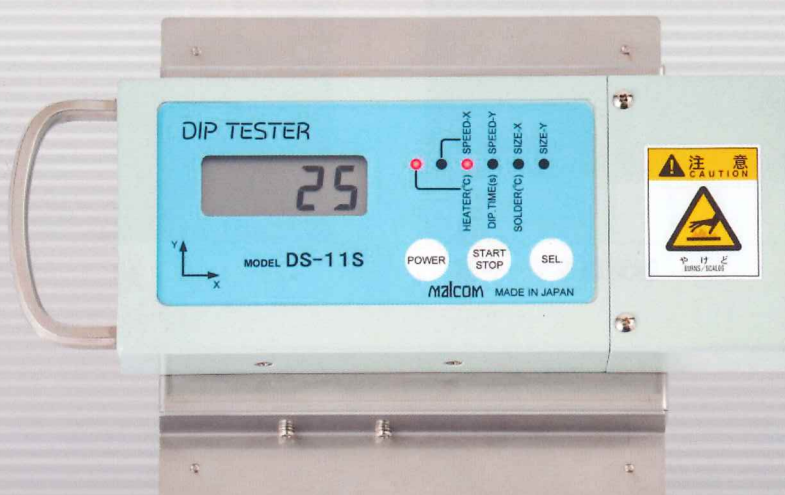


DS-11S

ディップテスター
 <セレクトィブはんだ付け装置用>

SELECTIVE SOLDERING DIP TESTER



センサ基板（本体裏面）



セレクトィブ
 はんだ付け装置

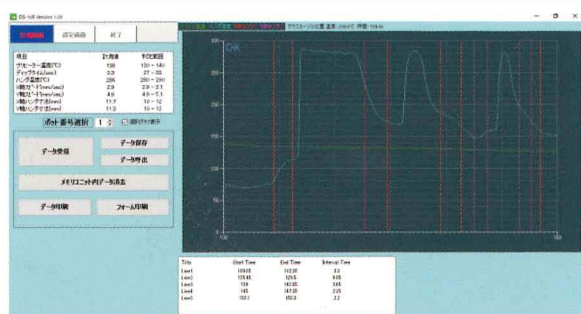
- セレクトィブはんだ付け装置専用のディップテスターがモデルチェンジしました
- USB通信・プロファイル測定機能搭載、専用ソフトを使用することで多彩な項目をより高度に測定可能となりました
- これまで手間がかかっていた装置の管理が簡便に行えるようになりました

ディップテスター DS-11Sは・・・

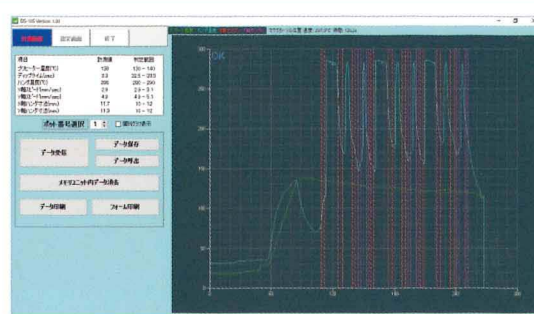
セレクトティブはんだ付け装置の管理に必要な情報を専用プログラムを使用することで、一括測定が可能となります

特長

- プリヒート・はんだ温度、XYスピードやXYノズルはんだ寸法などを自動判定するため、装置の状態管理が簡単に行えます
- 専用ソフトを使用することで、測定結果の合否判定・管理が行えます
- ノズルが複数ある装置でも最大10台まで、各ノズルの状態を個別に判定可能です
- PCを使用せずに本体表示部で全ての結果を確認できます



測定結果データ例



3連装置測定データ例

仕様

<各種センサ仕様>

項目	センサ	表示方法	測定範囲	精度	合否判定
基板下面表面温度	K型熱電対	LCD デジタル3桁	0～330℃	±1℃	PCソフト
はんだ温度	Kシース熱電対		0～330℃	±1℃	
ディップタイム	電極(2ピン×1ヶ所)		0～10.0秒	±0.2秒	
XYスピード	電極(2ピン×4ヶ所)		0～20mm/sec	—	
XY寸法	電極(2ピン×4ヶ所)		0～35mm	—	

<一般仕様>

項目	内容
冷接点補償	白金測温抵抗体により自動補償
耐熱性能(周囲温度)	150℃-5分以下 ※耐熱ケース装着で250℃-5分以下(オプション)
使用電池	単4乾電池 2個
外部接続	USB (TypeA-TypeC)
メモリ数	1データ(10ノズルステージ対応)
サンプリングタイム	0.1秒(固定)
外形寸法	W140×D214×H52 (mm)
重量	900g(電池含まず)

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください
 ※掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承下さい

株式会社 **マルコム**

【本社】 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
 TEL:03-3320-5611 FAX:03-3320-5615
 URL: <https://malcom.co.jp>
 【湘南支店】 〒257-0015 神奈川県秦野市平沢181-1
 TEL:0463-85-3411 FAX:0463-85-3255

代理店

OKTEK

岡業科技股份有限公司
 23586新北市中和區中正路866-3號13F
 Tel: (02) 2222-5799
 Fax: (02) 2222-5886